



格物光学1310nm波长的半导体光放大器 (SOA) 芯片系列专为高增益,高功率,低偏振和宽谱SOA模块而设计,符合GR-468-CORE标准。该COC全工艺国产,与国外主流常见产品兼容,并可满足客户快速订制需求,同时交期短、供货快。

产品特点

- ▲ 全工艺国产,自主可控
- ◆ 与主流厂家结构尺寸一致,兼容性强
- ◆ 性价比高,交期短,供货快,需求订制,快速迭代

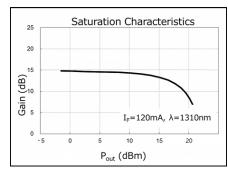
产品应用

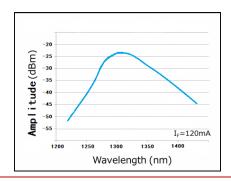
- ◆ 蝶形或小box封装的SOA,用于高速业务信号的光放大
- ◆ 集成在100G光模块的ROSA或TOSA中,提高光功率预算
- 用于硅光子集成产品,弥补1310nm光信号的传输损耗

产品规格

<u> </u>						
参数	符号	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
ASE中心波长		If=50mA		1310		nm
ASE中心波长		If=300mA		1265		nm
工作波长		T=25°C	1240	1260	1320	nm
带宽	Δ	@-3dB	60			nm
小信号增益	G	If=300mA/Pin=-25dBm		25		dB
饱和光功率	P _{sat}	If=300mA	16			dBm
偏振相关增益	PDG			1.0	2.0	dB
噪声系数	NF			7.5		dB
工作电流	lf			250	400	mA
正向电压	Vf				1.8	V
光斑尺寸	L/ T			16/30		o
芯片出光角度				30		0
热敏电阻阻值	R_{therm}	T=25°C	9.5	10	10.5	K
热敏电阻电流	l _{therm}				5	mA
工作温度	T _c	I=lop	20		40	°C
存储温度	T_{stg}		-40		85	°C
芯片尺寸	900*400*100 (± 15)					μm
COC尺寸	2.5*0.9*0.45					mm

典型特性







#